

YAMAHA, 고성능 ISDN 칩 개발

Yamaha Systems Technology는 ISDN(Integrated Services Digital Network) Layer 1과 Layer 2를 모두 지원하는 ISDN 인터페이스 컨트롤러를 업계 최초로 개발, 지난 Comdex 전시회에서 발표했다.

Yamaha에 따르면, 이번엔 개발된 "YM7405B" 칩은 아날로그 드라이버와 리시버를 내장하고 있으며, 다른 ISDN 부품들과도 호환성을 갖추고 있다. 특히 이 칩은 PCMCIA 카드에도 사용할 수 있도록 소형으로 설계돼 있다.

Yamaha는 고속 인터넷 접속 장비, 화상회의시스템, 원격 LAN(Local Area Network) 장비 등에 이 칩을 활용할 수 있다고 밝혔다.

IBM, 내년에 OS/2 WARP 새버전 발표 예정

IBM은 PC용 운용시스템 소프트웨어 "OS/2 Warp" 새 버전을 내년에 발표하겠다고 밝혔으며 OS/2를 포기하지 않겠다는 의지를 재천명했다. IBM산하 Personal Software Products 부문 책임자에 최근 임명된 John W. Thompson씨는 Comdex 전시회에서 15일 가진 회견을 통해 OS/2 Warp Server를 현재 베타 테스트 중이

며, 클라이언트용 OS/2 Warp 새 버전도 내년에 발표할 계획이라고 밝혔다.

Thompson씨에 따르면, 현재 IBM은 프로젝트 코드명 "Merlin"을 사용해 클라이언트용 OS/2 Warp 새 버전을 개발하고 있는데, 이 버전에서는 네트워크 지원기능, 멀티미디어 게임 기능, Plug and Play 기능 등이 대폭 향상되고 사용자 인터페이스도 더욱 사용하기 쉽게 개선될 예정이다.

NEC, PACKARD BELL, GVC : 중국에 모니터 공장 합작 설립

NEC, Packard Bell Electronics, 대만의 GVC 등 세 회사는 PC용 모니터 생산 공장을 중국에 합작 건설하기로 했다고 발표했다.

이들 세 회사는 합작 업체 NPG Display를 12월중 홍콩에 설립하고, 이 회사를 통해 중국 Guangdong 지방의 Dongguan에 공장을 건설할 계획이다. 이 공장은 내년 5월부터 월 12만대의 모니터를 생산, 중국 시장에 공급하게 된다.

NEC는 이 합작 사업에 총40억 엔이 투입될 것이라고 밝혔다. NEC는 Packard Bell 지분의 19.9%를 지난 8월 매입한 바 있으며, 대만의 GVC Corp.는 Pack-

ard Bell에 모니터를 공급하고 있다.

Maxtech, 염가형 DSVD 모델 발표

Maxtech은 모뎀, 팩스 및 음성 통신 기능을 모두 갖춘 염가형 모뎀 "XSVD 2881"을 개발, 2백 59달러에 시판한다고 Comdex 전시회에서 발표했다.

Maxtech에 따르면, 이 모뎀은 최고 28.8Kbps(Kilobits per second)까지의 속도를 지원하며, Digital Simultaneous Voice & Data(DSVD)표준에 부합한다. DSVD 기술은 한개의 통신회선을 통해 데이터 및 음성통신을 동시에 가능하게 해준다.

ATI, 입체 그래픽스 가속용 칩 발표

캐나다 Toronto에 있는 ATI Technologies사는 입체 그래픽스 가속용 칩 "3D Rage"를 개발했다고 지난 Comdex 전시회에서 발표했다. ATI에 따르면, 이 칩은 내년 1/4분기부터 대량 공급 되는데, 시판 가격은 1만개 기준 48달러로 책정됐다.

ATI는 3D Rage 칩을 사용하면 시판 가격 2백 50달러 수준의 그래픽스 가속용 아답터를 개발할 수 있을 것으로 전망하고 있다.

ESS TECH, WINDOWS 95 용 오디오 칩 발표

캘리포니아주 Fremont에 있는 멀티미디어 PC용 오디오 칩 개발 업체인 ESS Technology사는 Windows 95운용시스템이 “Plug and Play” 표준을 지원하는 오디오 칩 “ES1868 Audio Drive”를 개발했다고 발표했다. ESS에 따르면, 이 칩은 FM Synthesis, Full-Duplex Operation, 16-bit 스테레오 사운드 기능을 모두 갖추고 있으며, 내년 1/4분기부터 대량 생산될 예정이다.

IBM, 네트워크용 엮가형 PC 공급 예정

IBM이 네트워크용 엮가형 PC를 개발, 내년부터 공급할 계획이다. IBM의 Louis V. Gerstner 회장은 Las Vegas에서 개막된 Comdex 전시회 기조 연설에서 IBM이 고속 네트워크 사용자들을 위한 “Inter-Personal Computer (IPC)”를 공급할 계획이라고 밝히고, 이러한 계획은 컴퓨터 업계의 제3의 물결이라고 할 수 있는 “네트워크 혁명”을 주도하기 위한 것이라고 말했다.

한편, IBM의 기업용 PC부문 책임자 ozzie Osborne씨는 IBM이 네트워크용 엮가형 PC 개발을 지난 1년여 동안 추진해 왔다고 밝히고, 제품 가격은 2천달러에는

크게 미달할 것이지만 5백달러 수준까지 낮아지지는 않을 것이라고 전망했다.

IBM이 공급할 IPC는 플로피 디스크 드라이브가 없고, 소용량 하드 디스크를 갖추고 있으며, 기능 확장 또는 업그레이드가 불가능하다.

또한 IBM은 자사의 PowrPC 기종 PC에 사용하기 위해 Apple Computer의 Macintosh 운용시스템을 라이센스할 방침이라고 밝혔다. IBM의 Power Personal System 부문 책임자 Tony Santelli씨는 Comdex 전시회에서 가진 기자 회견을 통해 내년 중반에 발표될 예정인 PowerPC 기종 PC에 Macintosh 운용시스템을 탑재하기 위한 라이센스 협상에 착수할 계획이라고 말했다.

한편, PowerPC용 OS/2 운용시스템 공급 일정은 내년 1/4분기까지 지연될 전망이다.

SONY, 미 PC시장 진출 예정

Sony가 미국의 가정용 PC시장에 진출할 예정이다.

업계 관계자들에 따르면, Sony는 자사의 우수한 상표 이미지와 PC에 사용되는 부품의 대부분을 이미 생산하고 있다는 점을 활용하면 PC 시장에서도 승산이 있다고 결론을 내렸으며, 이에 따른 PC사업 계획을 Comdex 전시회

에서 발표할 것으로 전망된다.

Sony는 일본에서는 이미 오랫동안 워크스테이션과 PC를 시판해왔으며, 미국의 Dell Computer와 Apple Computer가 판매중인 노트북 PC도 생산하고 있다.

미국에서 Sony는 텍사스주 San Antonio에 반도체 공장을 소유하고 있고, 캘리포니아주 San Jose에는 컴퓨터 관련 기술 연구 센터를, 캘리포니아주 San Diego에는 컴퓨터 모니터 생산공장을 두고 있다.

나아가 Sony는 데이터 저장장치와 휴대형 컴퓨터용 Lithium Ion 배터리도 공급하고 있다.

동시에, Sony가 진출할 예정인 가정용 PC 시장에서는 이미 경쟁이 치열할 뿐 아니라, 가정용 PC 수요 증가율도 둔화되고 있다는 점은 Sony의 사업계획에 있어서 위험 요소인 것으로 지적되고 있다.

캘리포니아주 San Francisco에 있는 시장조사 업체 Odyssey Ventures Inc.에 따르면, 연소득 5만달러 이상인 미국 가정의 60%가 최소한 현대 이상의 PC를 이미 소유하고 있다.

UMAX, 6배속 CD-ROM 드라이브 공급

UMAX Technologies는 Windows 95, Windows NT, DOS 및 OS/2 환경에서 사용할 수 있는

내장형 6배속 CD-ROM 드라이브 “Maxima CD-IS601”을 개발, 2백89달러에 시판한다고 발표했다. UMAX에 따르면, 이 드라이브는 초당 900KB의 데이터를 처리할 수 있으며, Windows 95 운영시스템의 “Plug and Play” 기능을 지원한다.

Broadcom, Set Top Box 칩 개발

Broadcom는 케이블 TV용 디지털 Set Top box에 사용할 수 있는 데이터 전송용 칩 “BCM 3115 QAM Link Dual-Channel Receiver”를 개발, 시제품을 공급하기 시작했으며 내년 중반부터는 1천개 기준 70달러에 대량 공급할 계획이라고 발표했다.

이 칩은 Broadcom과 Hewlett-Packard(HP)가 협력해 개발했는데, HP는 내년 중반부터 대량 공급할 예정인 “Kayak” 기종 Set Top box에 Broadcom의 칩을 사용할 예정이다.

Broadcom에 따르면, BCM 3115칩을 사용하면 Set Box 생산 비용을 180달러까지 낮출 수 있다.

Toshiba, 대만 Winbond에 DRAM 기술제공

Toshiba가 대만의 Winbond Electronics에 DRAM기술을 제

공할 예정이다.

업계 관계자들에 따르면, 양사는 현재 DRAM분야 제휴를 위한 협상을 추진 중인데, 이번 제휴를 통해 Winbond는 1997년부터 DRAM시장에 진출할 것으로 전망된다.

이들 두 회사의 협상 내용에 따르면, Toshiba는 자사의 Sub-micron기술을 Winbond에 우선 제공, Winbond를 통해 16- 및 64-megabit DRAM을 공급받을 예정이다.

Winbond는 현재 8인치 웨이퍼 공장을 건설 중인데, 월4만장의 웨이퍼를 생산할 수 있는 이 공장은 1997년 완공 예정이다.

이 과정을 거친 후 Winbond는 자체 상표를 부착한 DRAM을 판매할 수 있는 권리도 Toshiba에서 확보할 예정이다.

DEC, 초고속 ALPHA 프로세서 시제품 공급

Digital Equipment Corp.(DEC)는 0.35-micron 기술로 생산되는 “Alpha 21164” 프로세서 시제품을 발표했다.

DEC에 따르면, 이 프로세서의 성능은 500 SPECint92와 750 SPECfp92, 11 SPECint95와 17 SPECfp95를 능가, 세계에서 가장 우수한 것으로 평가되고 있다.

DEC는 Alpha 21164의 후속 제품을 1997년까지 개발, 1000

SPEC92에 해당하는 성능을 실현할 계획이라고 밝혔다.

SUN, 64-BIT 워크스테이션 신제품 발표

Sun Microsystem는 이 회사의 64-bit 마이크로프로세서 “UltraSparc”를 사용하는 “UltraComputing” 시리즈 워크스테이션을 발표했다.

Sun에 따르면, UltraSparc 프로세서는 멀티미디어 및 네트워킹 기능을 내장하고 있으며, 이를 사용한 워크스테이션은 Sun의 기존 제품들보다 속도가 최대 4배까지 빠르다.

Sun은 UltraSparc 프로세서를 사용하는 UltraComputing 플랫폼에 입각한 제품을 오는 2000년까지 사용할 방침이다.

Sun의 UltraSparc 기종 워크스테이션 신제품은 1만7천~3만 달러에 시판된다.

Toshiba, SD방식 디스크 드라이브 개발

Toshiba는 “Superdensity(SD)” 디스크 표준을 지원하는 ROM (Read Only Memory) 드라이브 시제품을 업계 최초로 개발했다고 발표했다. Toshiba에 따르면, 이 드라이브는 CD-ROM 디스크의 7배에 해당하는 데이터를 수록할 수 있는 5인치 SD 디스크를 사

용, 초당 1,350 Kilobytes의 데이터를 처리할 수 있다.

Mitsubishi, 싱가포르에 디스크 드라이브 공장 건설

Mitsubishi는 싱가포르에 약 3천5백만달러를 투자, 하드 디스크 드라이브 공장을 건설할 계획이다.

Mitsubishi 관계자들에 따르면, 이 공장은 내년 중반부터 가동, 월 40만대의 제품을 생산할 예정이다.

Mitsubishi는 CD-Recordable (CD-R) 디스크 생산 공장을 지난 5월 싱가포르에서 완공한 바 있는데, 이 공장의 제품 생산량 또한 월 13만장에서 월 50만장으로 증가될 예정이다.

Hitachi, 실리콘밸리에서 노트북 PC 생산 예정

Hitachi가 내년부터 미국의 휴대용 PC시장에 본격 진출하기 위해 실리콘밸리에 PC조립 공장을 세우기로 했다.

Hitachi의 Ryuichi Otsuki 대변인에 따르면, Hitachi는 캘리포니아 주 San Jose에 2천만 달러를 투입해 Hitachi PC Corp를 설립, 내년 봄부터 업무용 노트북 PC를 조립 생산할 예정이다.

이를 통해 Hitachi는 미국의 PC시장을 본격적으로 공략, 오는

2000년까지는 PC업계 10위권에 진입 한다는 방침이다.

시장조사 업체 International Data Corp(IDC)에 따르면 미국 내 휴대용 PC 판매량은 금년에 4백 12만대에 해당, 작년보다 28.7% 증가할 전망이다, 탁상용 PC 판매량은 작년보다 18.9% 증가한 1천8백16만대에 이를 것으로 예상된다.

SEGA, 아일랜드에서 CD-ROM 소프트웨어 생산

Sega Enterprises는 자사의 "Sega Saturn"게임기용 CD-ROM 소프트웨어를 11월초부터 아일랜드에서 생산할 계획이라고 발표했다.

이번 프로젝트는 Victor Co. of Japan(JVC) 및 Hitachi Ltd와 공동으로 추진되는데, 제품 생산은 Hitachi 산하 Hitachi Maxell이 Dublin에 소유하고 있는 공장이 담당한다.

이 공장은 올 12월까지의 월 25만장의 CD-ROM 소프트웨어를 생산하고 내년 1월부터는 생산량을 월 70만장으로 증가시킬 예정이다.

지금까지 Sega는 유럽에서 판매할 CD-ROM 소프트웨어의 대부분을 미국에서 생산해 왔는데, 아일랜드로 생산기지를 이전함으로써 Sega는 경비의 약 6%를 절감할 것으로 전망하고 있다.

모토로라, 디지털 신호처리용 칩 발표

DSP56301은 모든 DSP56300 계열 칩과 같이, 한 명령어를 한 사이클에 수행하는 고성능 DSP 엔진과 풍부한 명령어 세트 그리고 저전력소비의 특징을 갖는다. DSP56300 모듈 디자인 방법은 특정 마켓과 소비자의 수요에 신속한 디자인과 최적화를 제공한다. DSP56300코어를 갖는 DSP56301은 증가하고 있는 모토로라 DSP라이브러리로부터 표준 메모리와 주변 모듈을 추가하였다.

추가적으로는 모토로라는 첫 번째로 완전히 군더더기 없는 PCI 버스 인터페이스를 개발하여서 DSP56301 칩 내부에 이 특징을 집어 넣었다. 이 특징은 추가적으로 인터페이스하는 칩의 필요성을 줄이면서 시스템 가격을 줄이는데 기여하였다.

더우기 PCI버스를 칩내부에 집적화 시킴으로 데이터 전송을 보다 효율적으로 보다 빠르게 하게 한다. DSP56301 역시 DRAM, SRAM, SSRAM, ROM과 주변장치에 군더더기 없는 인터페이스를 제공하는 확장 버스를 포함한다.

DSP56301은 4K워드 PRAM을 갖고 있는데, 이것은 3K워드의 PRAM과 1K워드의 명령어 캐쉬로 재구성되어 질 수 있다. 외부의 프로그램 메모리를 사용할

때 명령어 캐시는 시스템 성능을 향상 시키거나 메모리 속도나 가격 요구치를 줄일 수 있다. 추가적으로 4K 워드의 데이터 메모리는 2K 워드의 X메모리와 2K 워드의 Y메모리로 나눌 수 있다.

DSP56301은 역시 두개의 개선된 동기식 직렬 인터페이스(ESSI)를 제공한다. 이것은 아나로그 컨버터에 대한 고속직렬 링크를 제공하며 다른 데이터 속도를 제공할 수 있다. 직렬 통신 인터페이스(SCI)와 3개의 16비트 타이머도 역시 제공된다.

싸이버텍홀딩스, 미국 Check-Point사의 Firewall-1 V 2.0

한국 공급계약 체결

인터넷 관련 각종 요소제품 공급과 인터넷 SI 등 인터넷 관련 토털 솔루션 제공을 목표로 '95년 9월 1일 설립된 (주)싸이버텍홀딩스는 그 첫번째 사업으로서 지난 11월 11일 인터넷 보안 솔루션 중 세계 최고를 자랑하는 Check Point사의 Firewall-1 V 2.0에 대한 국내 공급계약을 체결하였다.

이스라엘에 본사를 두고 있는 CheckPoint사는 전 세계적인 명성을 자랑하는 인터넷 보안 솔루션 전문업체이며, 특히 인터넷 보안 대책 부분에서 가장 앞서가고

있는 미국시장에서 시장점유율 56%로서 유료 패키지 중에서 점유율 1위를 차지하고 있는 업체이다.(약 2500개 이상의 업체 및 기고나에 설치 가동 중)

최근 국내에도 소개되면서 점차 관심을 끌고 있는 Firewall은 로컬 네트워크와 인터넷 간에 완벽한 쌍방향 커뮤니케이션을 가능하게 하면서도 인가되지 않은 접속 시도를 완벽하게 차단해주고, 또한 최고 수준의 네트워크 퍼포먼스를 유지해주면서도 모든 사용자 및 어플리케이션에 대한 투명한 연결성을 보장해주는 가장 앞선 인터넷 보안 솔루션이다.

용어해설

C A S E

CASE는 common application service element의 약어로 통신프로토콜의 應用層에 있어서의 공통 응용 서비스 요소를 말한다.

다양한 異機種 컴퓨터간에 자유롭고 원활한 통신을 할 수 있도록 하기 위해 표현형식 등을 정해놓은 통신규약인 프로토콜에 의해 처리를 실행하게 되는데, 네트워크의 논리구조·통신의 실행순서 등을 네트워크 아키텍처로서 체계적으로 통일, 이를 階層化한 것을 계층화 프로토콜이라 한다. 네트워크층, 전송포트층, 세션층, 어플리케이션층)중의 상위층인

애플리케이션(응용)층의 본질적인 실체를 애플리케이션 엔티티라고 하는데, 이는 CASE와 특정 응용서비스 요소(SASE : specific application service element), 사용자요소(UE : user element)의 3요소로 구성돼 있다.

응용층인 애플리케이션 층은 복수의 시스템상의 응용프로그램이 상호 통신하면서 일련의 업무처리를 실행할 수 있도록 필요한 서비스기능을 제공하는 것으로서, OSI(open system interconnection : 개방형 상호 접속)환경 밖의 로컬시스템 내의 응

용프로세스와 인터페이스를 취해 응용층의 서비스기능을 실현한다.

CASE는 응용층 내에서 공통으로 사용되는 서비스 요소로, 여기에는 현재 어소시에이션 제어·코미트먼트 제어 등이 있다. 어소시에이션 제어는 응용엔티티間的 어소시에이션 설정·해방·강제종료 등에 관한 기능이며, 코미트먼트 제어는 분산된 응용프로세스의 同期갱신 등 복수의 시스템에 걸친 일반적인 분산처리의 同期기능을 제공하는 서비스이다.